

BUSS KNEADER TECHNOLOGY



半導体封止材用PCSシリーズ

エポキシモルディングコンパウンド (EMC) は、集積回路 (IC) やダイオード、トランジスタ、半導体などさまざまな電子素子を保護する最適な封止材です。その優れた電気的、機械的、化学的な性質が、この材料を電気製品や自動車用途に適したものにしています。EMCのその傑出した品質を十分に生かすには、低温でかつ完全にコントロールされた温度状態で高充填のフィラーを良好に分散できる混練装置が必要です。ブスの混練技術は、過去60年間にわたり、このような高度な要求に対応し続けており、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリエステル樹脂、メラミン樹脂、ユリア樹脂など熱硬化性樹脂をベースとするコンパウンドのモルディングにおいて、その性能の高さは実証されています。

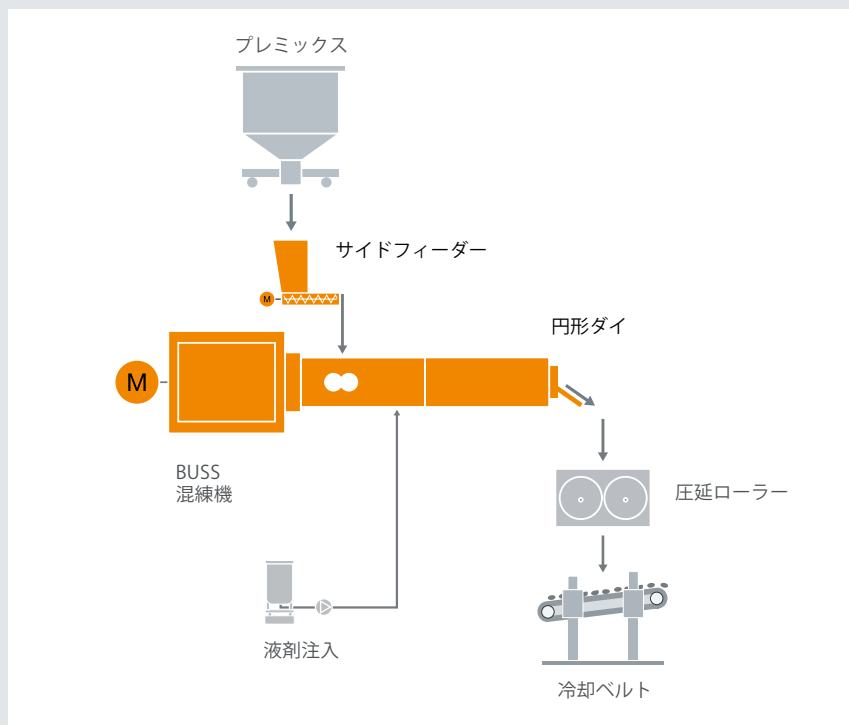


BUSS

excellence in compounding

PCSシリーズは最高品質のEMCコンパウンドを提供します

- 低温での強力な分散混合**
 ブッス・ニーダーは、スクリーウの回転運動と軸方向の往復動により、伸長流や多数のせん断界面、クロスチャンネルミキシングを生成し、強力な分配混合を実現しています。熔融と混合のエネルギーは、ほぼ全てが機械的に生成されます。
- 均一で適度なせん断速度**
 適度なせん断速度により、所定の作業に必要なせん断のみを行い、低温での混合材料の混練を可能にします。またせん断速度のバラツキが小さいため、全ての粒子のせん断履歴を均一にすることができ、より小さな入力エネルギーにより、高品質なコンパウンド材料を得ることが可能です。
- 正確な温度制御**
 ブッス・ニーダーの温度制御の正確性は、60年以上にわたり多方面から評価されています。均一なせん断速度による制御されたエネルギー入力と、プロセス部の各箇所に取り付けられた熱電対内蔵混練ピンによる正確な温度モニタリングの組み合わせにより、この正確な温度制御が実現されています。



- フィラー充填率の高さ**
 追加の原材料供給口やフィラーの分割供給、バックベントによるトラップエアアの除去、そして優れた輸送効率により、最大で90wt%のフィラー投入が可能となっています。また適度なせん断速度により、このような高投入量でも極めて高い粘性の材料を扱うことができます。
- 高耐摩耗性エレメント**
 新規開発のタングステンカーバイド合金によるスクリーウエレメントや混練ピンは、EMCなどの摩耗性の高い用途でも優れた混練性能を持続させます。従来の耐摩耗材料で作られた製品と比較して、エレメントの寿命は大幅に伸びています。

テクニカルデータ

型式	ブッス混練機				
	スクリーウ径 [mm]	スクリーウ有効長 [L/D]	スクリーウ回転速度 [rpm]	駆動電動機出力 [kW]	最大処理量 [kg/h]
PCS 70	70	8 ... 14	250	30	200
PCS 100	100	8 ... 14	250	75	500
PCS 140	140	8 ... 14	250	110	1000
PCS 200	200	8 ... 14	250	200	1800

株式会社ブッス・ジャパン
 〒135-0034
 東京都江東区永代2-31-15
 ベルウッド永代6F

電話: 03-5646-7611
 Fax: 03-5646-7612
 info.jp@busscorp.com
 www.busscorp.com/jp


BUSS
 excellence in compounding